

Hirata

The Global Production Engineering Company

2021年3月期 第1四半期 決算説明資料

平田機工株式会社



I. 決算状況

2021年3月期 第1四半期 (4~6月)

Hirata



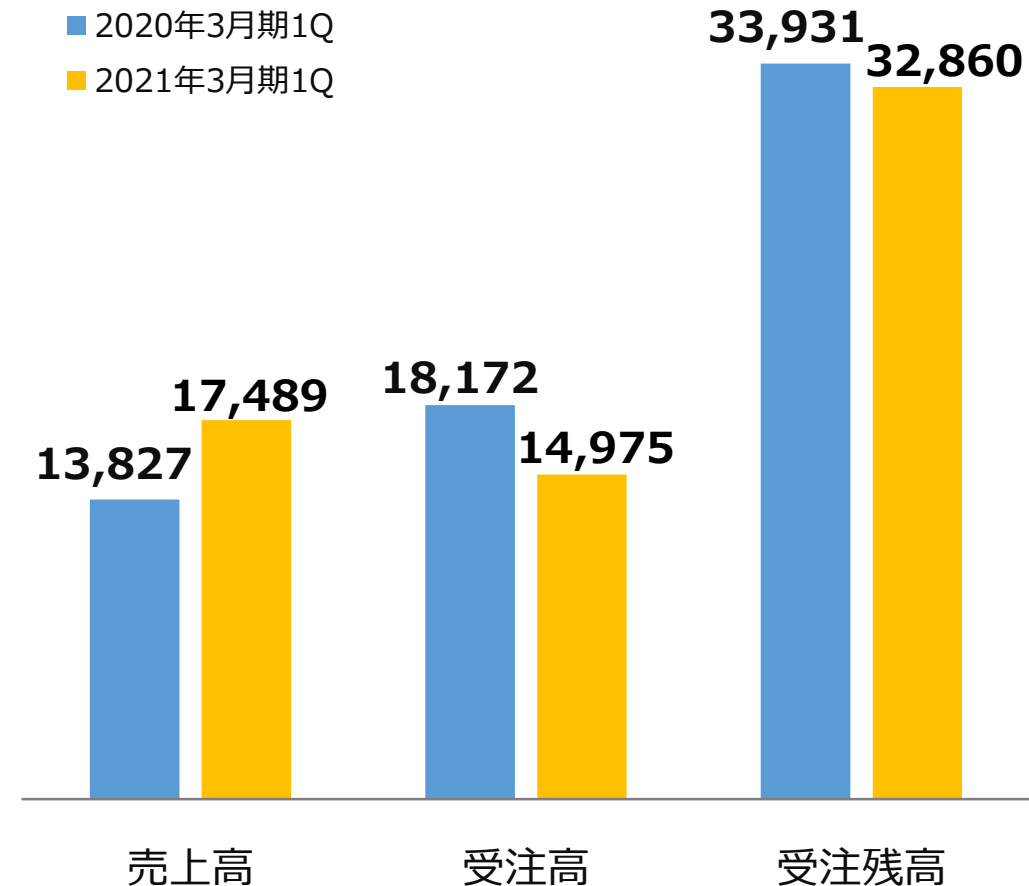
決算概要

新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、自動車関連などでは海外での営業活動が制限されるなど、厳しい受注状況が続いたが、半導体関連において5Gの本格化や在宅勤務拡大を背景としたデータセンター需要の高まりにより、装置メーカーから継続的な設備投資が行われたことで、半導体関連の売上高が前年同期を上回る水準で推移し、増収増益となった。

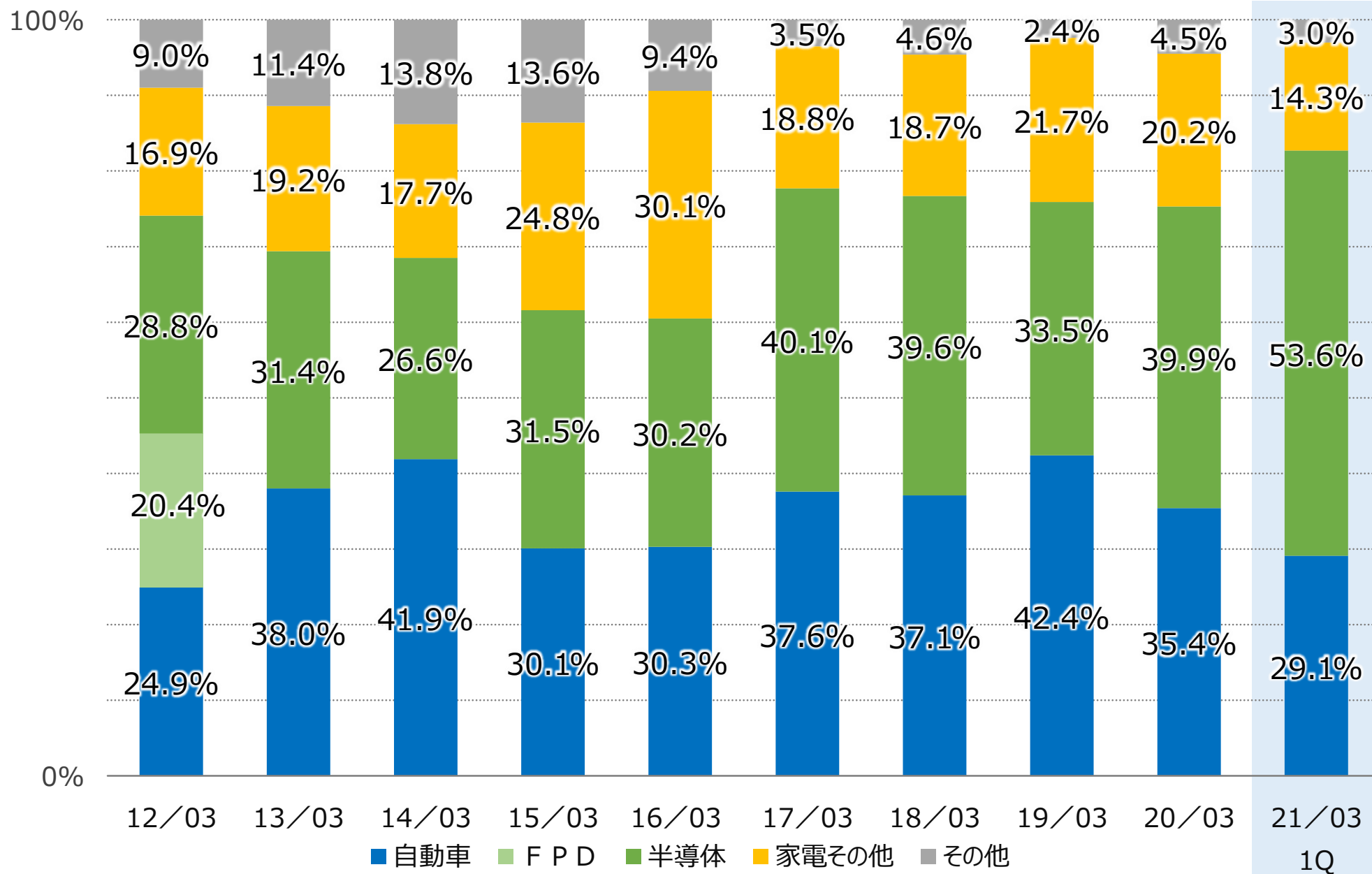
(単位：百万円)

	2020年3月期 1Q実績	2021年3月期 1Q実績	増減率
売上高	13,827	17,489	+ 26.5%
営業利益	593	1,518	+ 155.7%
経常利益	627	1,552	+ 147.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	430	951	+ 121.0%

(単位：百万円)

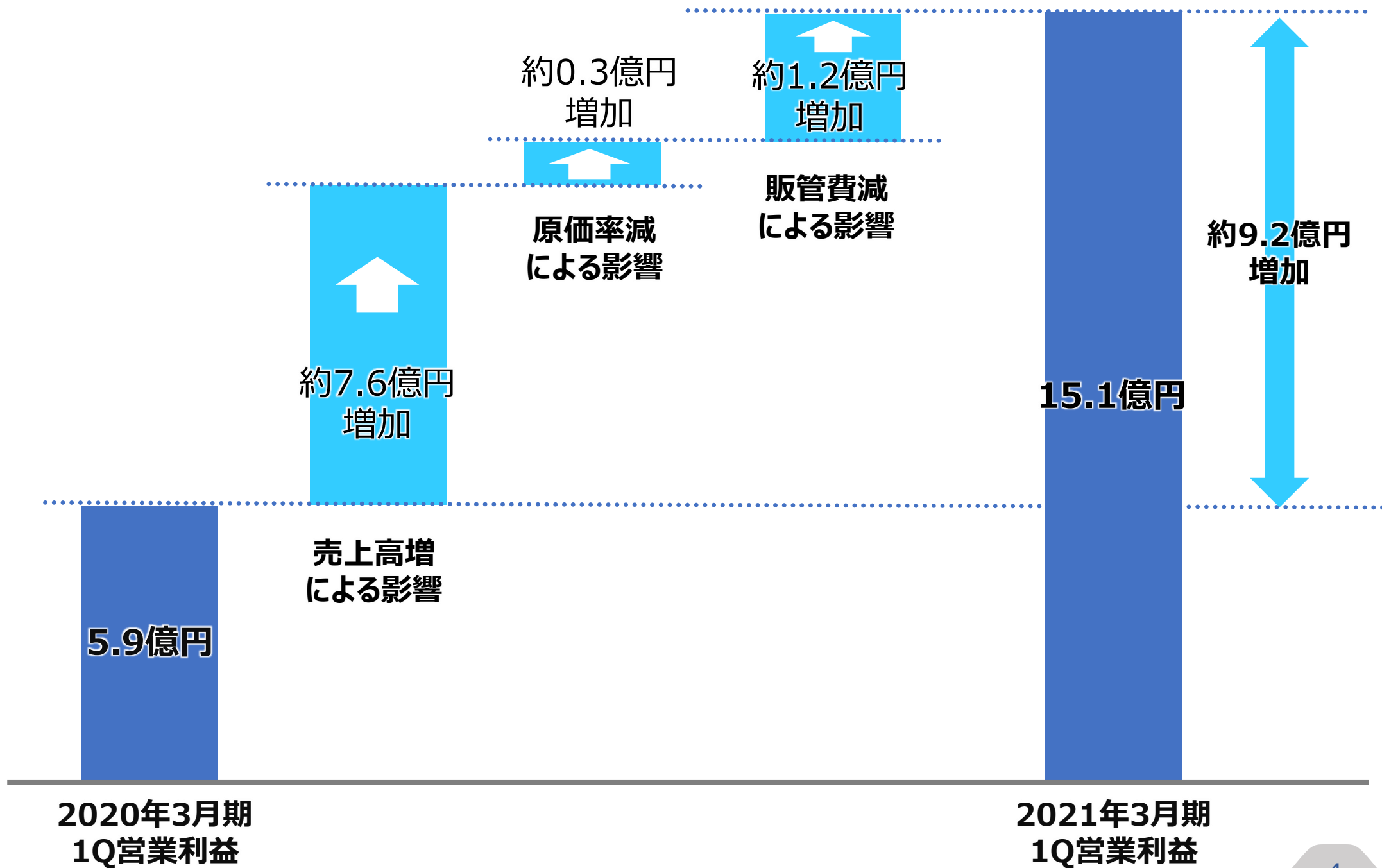


I 決算状況 事業部門別売上高構成比推移



※2013年3月期より、FPD関連事業は半導体関連事業に統合

I 決算状況 営業利益の増減要因分析



貸借対照表

(単位：百万円)

資産	2020年 3月期	2021年 3月期1Q	増減
流動資産	57,792	62,009	+4,216
固定資産	27,617	29,066	+1,449
有形固定資産	21,737	23,230	+1,493
無形固定資産	533	499	△33
投資その他資産	5,346	5,336	△9
資産合計	85,409	91,076	+5,666

負債	2020年 3月期	2021年 3月期1Q	増減
流動負債	28,831	30,199	+1,368
固定負債	9,585	13,364	+3,779
負債合計	38,416	43,564	+5,147
純資産			
純資産合計	46,993	47,511	+518
自己資本比率	54.4%	51.6%	△2.8Point

主な増減項目

資産

建物及び構築物	+4,333
建設仮勘定	△3,028
売上債権	+2,864

負債・純資産

有利子負債	+4,799
仕入債務	+2,024
未払費用	△685

想定為替レート

(単位：円)

想定為替レート	2020年4月1日～6月30日 実績レート	2020年7月1日～ 想定レート
為替レート (対US \$)	106.43	100.00

株価推移

(単位：円)

株価推移	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年3月期		
			4月	5月	6月
最高	10,580	8,150	5,300	6,550	6,320
最低	4,285	3,505	4,110	5,030	5,490
末日	7,640	4,605	5,240	6,190	5,630

PER/PBR/ROE

PER/PBR/ROE	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期1Q
PER (倍)	17.33	27.39	— ※
PBR (倍)	1.72	1.03	1.24
ROE (%)	10.06	3.77	— ※

※PER・ROEについては、四半期の利益では比較に適さないため記載しておりません。

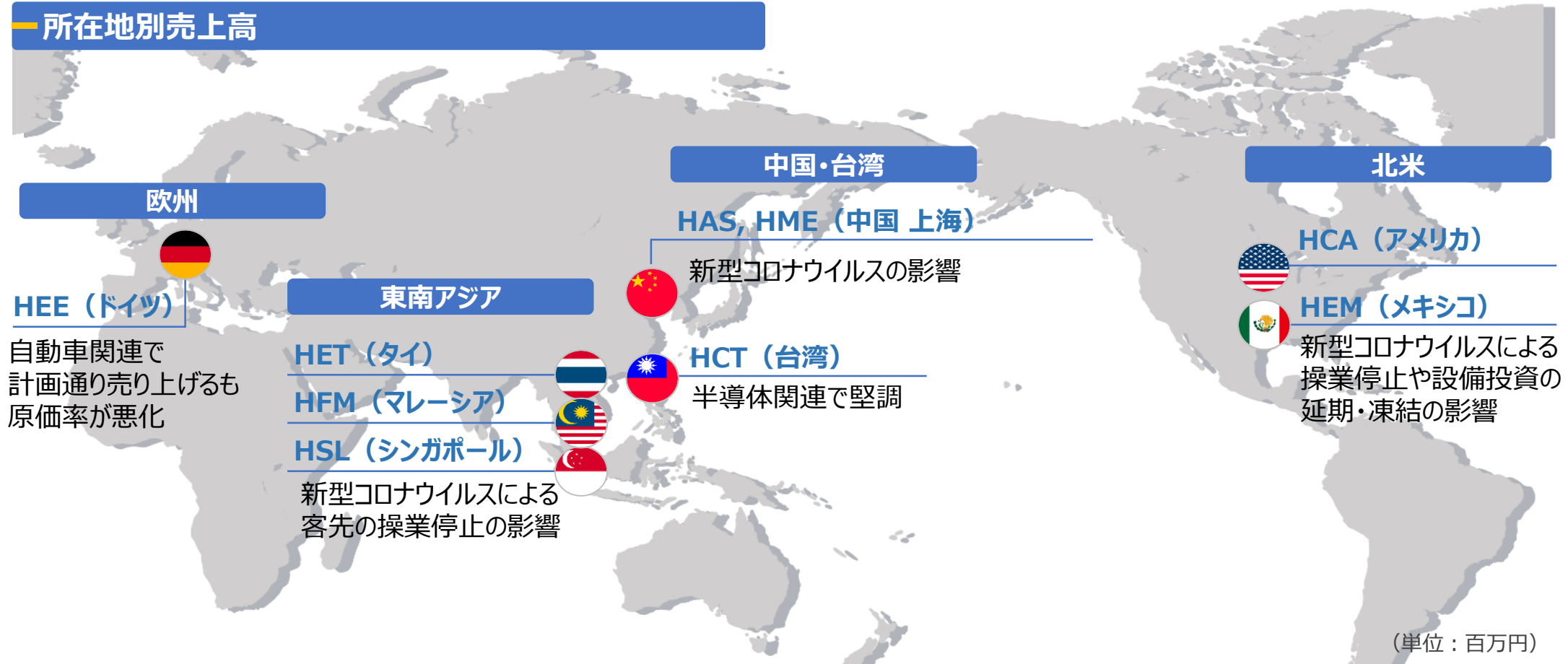
I 決算状況 事業部門別売上高・受注高・受注残高

(単位：百万円)

	事業部門	2020/3 第1四半期	2021/3 第1四半期	対前年同期比 増減率
売上高	自動車関連	5,047	5,088	+0.8%
	半導体関連	4,721	9,375	+98.6%
	家電関連およびその他	3,258	2,493	△23.5%
	その他	800	532	△33.4%
	合計	13,827	17,489	+26.5%
受注高	自動車関連	6,657	7,388	+11.0%
	半導体関連	8,452	5,547	△34.4%
	家電関連およびその他	2,279	1,606	△29.5%
	その他	783	433	△44.7%
	合計	18,172	14,975	△17.6%
受注残高	自動車関連	16,360	17,014	+4.0%
	半導体関連	11,830	11,144	△5.8%
	家電関連およびその他	5,142	4,362	△15.2%
	その他	597	339	△43.1%
	合計	33,931	32,860	△3.2%

I 決算状況 海外現地法人の状況

所在地別売上高



	日本		アジア		北米		欧州		合計	
	20/3 1Q	21/3 1Q	20/3 1Q	21/3 1Q	20/3 1Q	21/3 1Q	20/3 1Q	21/3 1Q	20/3 1Q	21/3 1Q
売上高	11,024	15,525	1,819	789	798	731	185	443	13,827	17,489
営業利益	193	1,725	613	△ 54	△168	△ 112	△21	△ 68	616	1,489

※営業利益の合計はセグメント間の消去を行う前の金額を表示しています。

有機EL関連・電気自動車（EV）関連状況

（単位：百万円）

	受注高			売上高		
	2020年 3月期1Q	2021年 3月期1Q	増減	2020年 3月期1Q	2021年 3月期1Q	増減
有機EL関連	4,759	2,046	△2,714	1,096	5,098	+4,002
電気自動車（EV）関連	1,876	494	△1,382	677	744	+67

●有機EL関連

半導体関連の売上のうち、有機EL関連は約54%の割合となり、前年比大幅増、受注高は前年比約57%減となりました。

●電気自動車（EV）関連

自動車関連の売上のうち、電気自動車（EV）関連は約15%の割合となり、前年比約10%増、受注高は前年比約74%減となりました。

Headquarters Building (新本社工場) 竣工

6月1日、当社の新本社工場となる「Headquarters Building」が竣工しました。延床面積2万2458平方メートルの4階建てで、本社機能と工場機能が一体となっております。また、これまで近隣工場に分散していた生産機能を集約することで、生産能力の向上を図ります。6月5日に行われた竣工式では、社長の平田が「新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経済状況が予想されるが、1つでも多くの仕事を受注し、熊本に還元できるようにしたい」と挨拶しました。



本社/熊本工場
※青ビル(中央)の右が
Headquarters Building



Headquarters Buildingの
事務所エリア

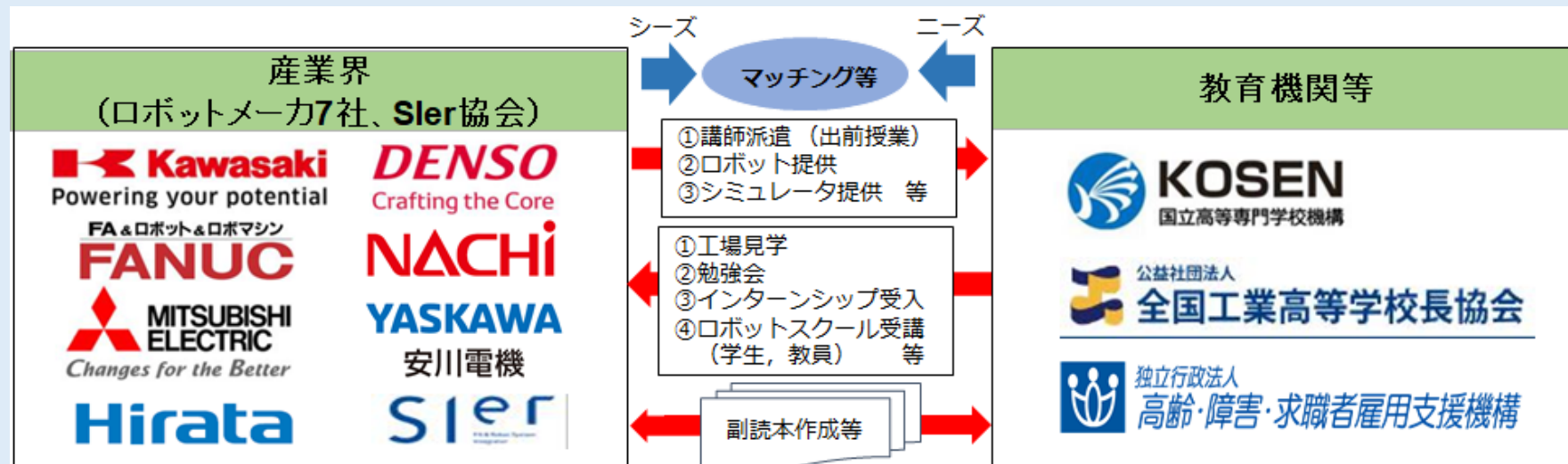


竣工式にて挨拶する
代表取締役社長 平田 雄一郎

I 決算状況 トピックス

未来ロボティクスエンジニア育成協議会に参画

6月24日に、産学が連携した「未来ロボティクスエンジニア育成協議会（略称：CHERSI）」が設立され、当社もこの趣旨に賛同し、参画しました。CHERSIは、高等専門学校や工業高校の教育機関における産業界に対するニーズと、ロボットメーカー／ロボットシステムインテグレータなどが有するシーズとのマッチングを通じた人財育成を担っています。産業界からは、当社を含め川崎重工業、デンソー、ファナック、不二越、三菱電機、安川電機のロボットメーカー7社、FA・ロボットシステムインテグレータ協会が参画しています。今後、CHERSIでは、高等専門学校の先生方がロボットメーカーなどを訪問して得た知見を学生に伝えるなどの活動が予定されています。



CHERSIの活動イメージ図
(ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会ホームページより)

Ⅱ. 市場動向および 2021年3月期業績の見通し

2021年3月期 第1四半期 (4~6月)

Hirata



(単位：百万円)

	2020年3月期 実績		2021年3月期 予想	
売上高	65,612		67,000	
自動車関連	23,225		25,000	
半導体関連	26,166		27,000	
家電関連およびその他	13,240		13,000	
その他	2,979		2,000	
営業利益 (率)	2,736	(4.2%)	1,900	(2.8%)
経常利益 (率)	2,861	(4.4%)	2,000	(3.0%)
親会社株主に帰属する 当期純利益 (率)	1,744	(2.7%)	1,100	(1.6%)

通期業績予想について

2021年3月期の業績予想につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大傾向により、当社グループの受注環境も不透明感が続くものの、現時点では半導体関連を中心として比較的堅調な売上計上ができるものと見込んでおり、増収の予想としております。一方で、各利益につきましては、予定しております設備投資に係る減価償却費や研究開発等の増加により、前期を下回るものと見込んでおります。

自動車関連事業

新型コロナウイルス感染症の影響による自動車市場の低迷を受け、完成車メーカー・部品メーカーの設備投資への慎重姿勢が続くと予想される。今後も新型コロナウイルス感染症の第2波に対する懸念の高まりなど、受注環境の不透明感は払拭できない状況であるが、EVなどの引合案件の受注に注力する。

半導体関連事業

5Gの本格化や在宅勤務やオンライン授業などが世界的に増加しており、データセンター向けCPUなどが半導体設備投資の刺激要因となっている。当社としては、今後も半導体設備投資への継続的な受注を確保していくとともに、堅調な有機EL関連設備の受注確保に努める。

家電関連およびその他

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、アジアなどでの生産活動が制限されたことで、企業の投資マインドも急激に縮小するとともに、今後についても不透明感が払拭できない状況が続くとみられる。家電関連設備の大型案件などの受注に努める。

1株当たり配当金・配当性向 推移

(単位：円)

	2017年 3月期	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期予想
1株当たり配当金	100.00	125.00 <small>うち記念配当25.00円</small>	125.00	40.00	25.00
配当性向 (%)	16.0	19.5	28.4	23.8	23.6

※配当性向は連結ベースです。

配当予想について

当社は、株主に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、財務体質の強化を図りつつ、連結業績や今後の事業展開などを勘案しながら、連結配当性向20%以上を概ねの目安とし、安定的・継続的におこなう様に努めています。

また、次期の配当につきましては、配当政策に基づき、業績予想に基づく利益水準と前期の配当性向などを勘案の上、25円の予想といたしました。

Ⅲ. 参考資料

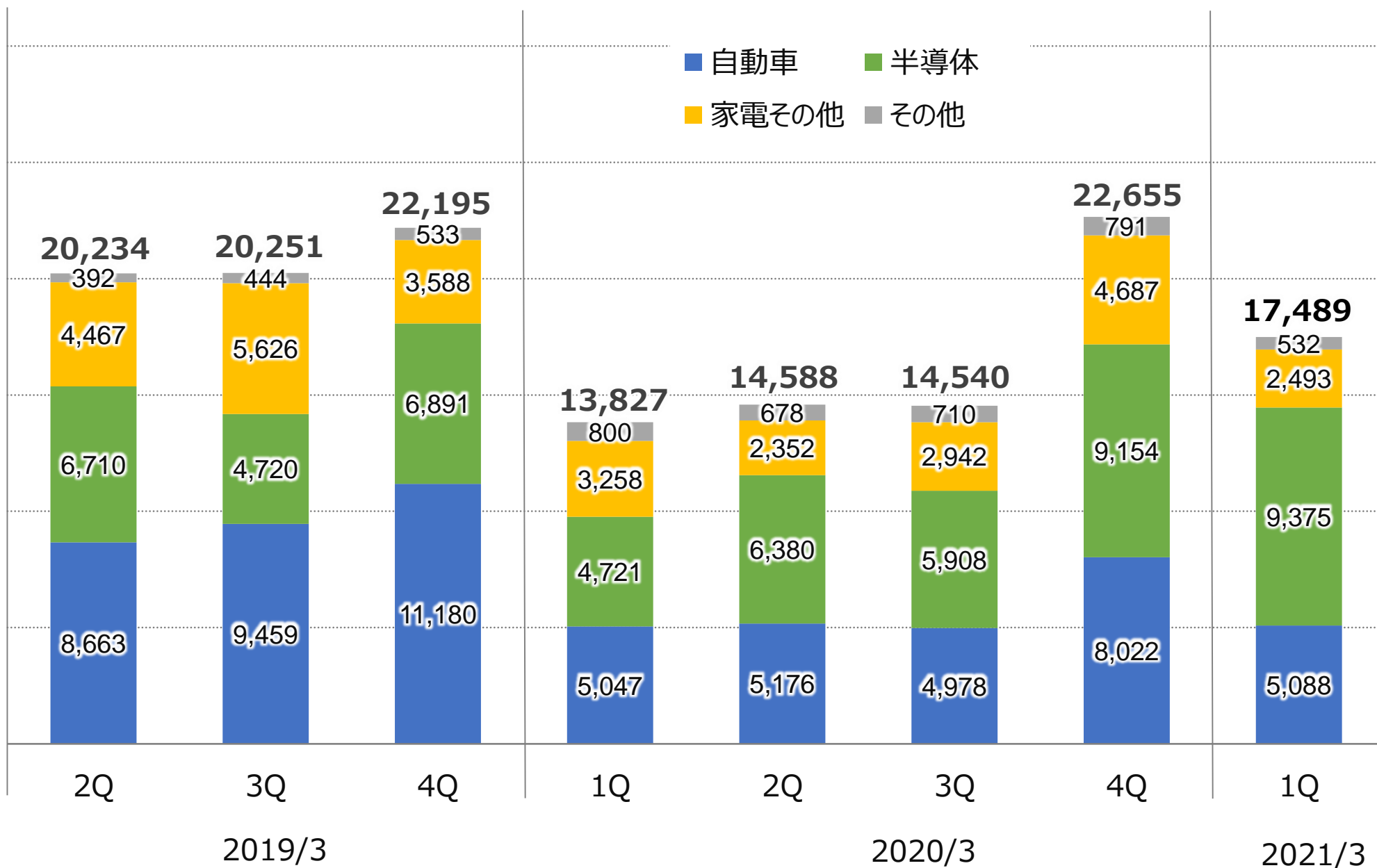
2021年3月期 第1四半期 (4~6月)

Hirata



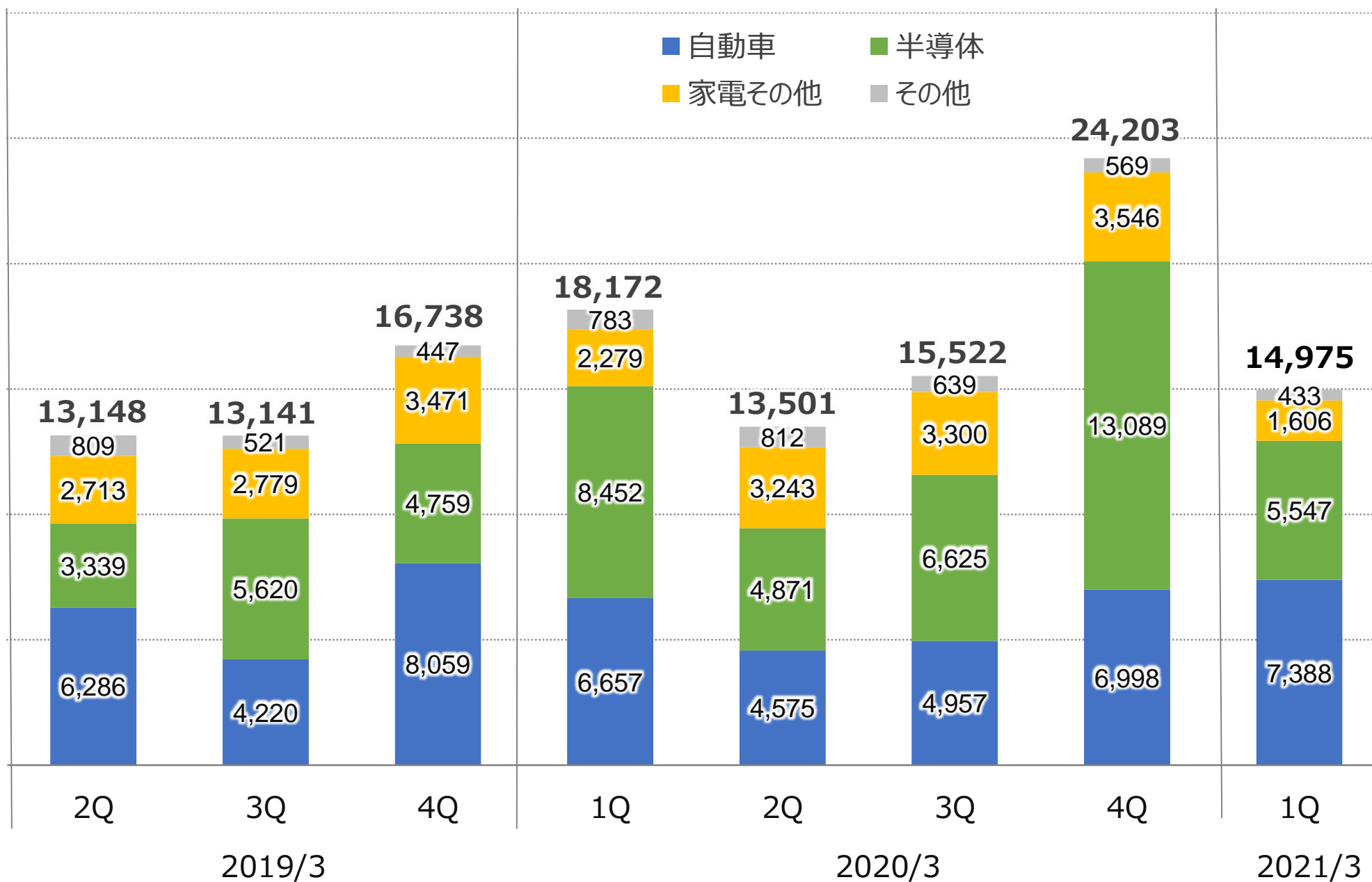
事業部門別四半期売上高の推移

(単位：百万円)



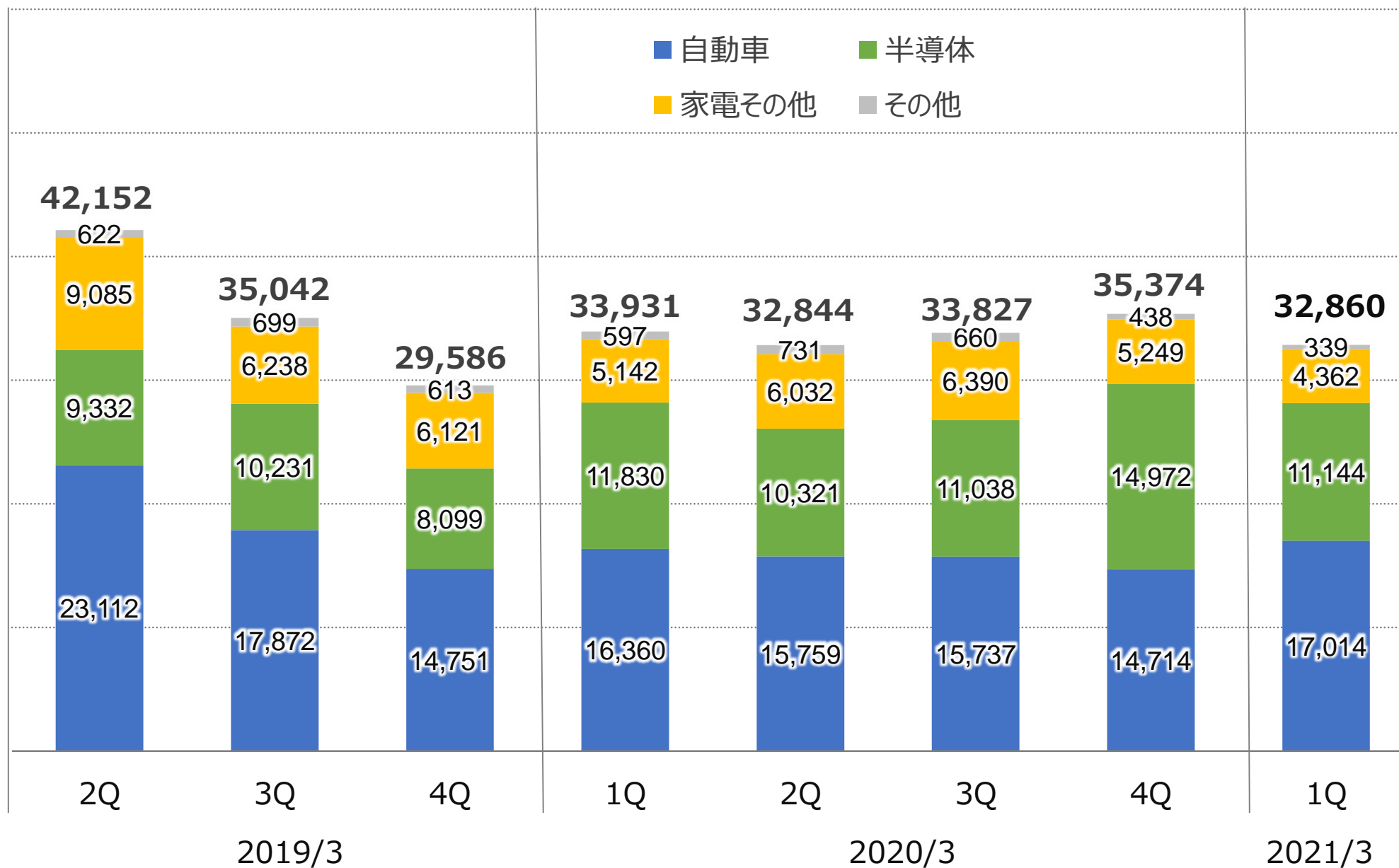
事業部門別四半期受注高の推移

(単位：百万円)



事業部門別四半期受注残の推移

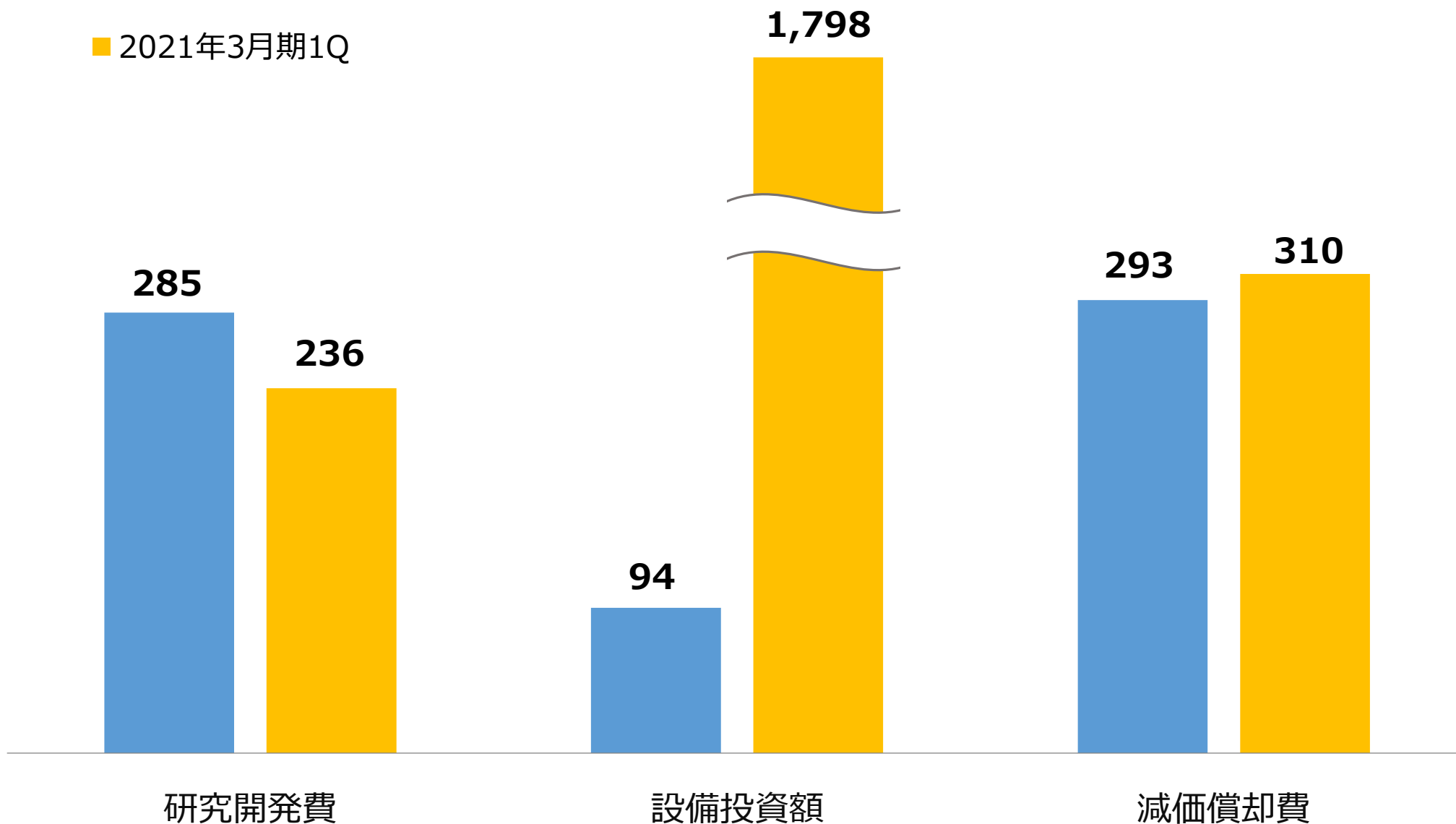
(単位：百万円)



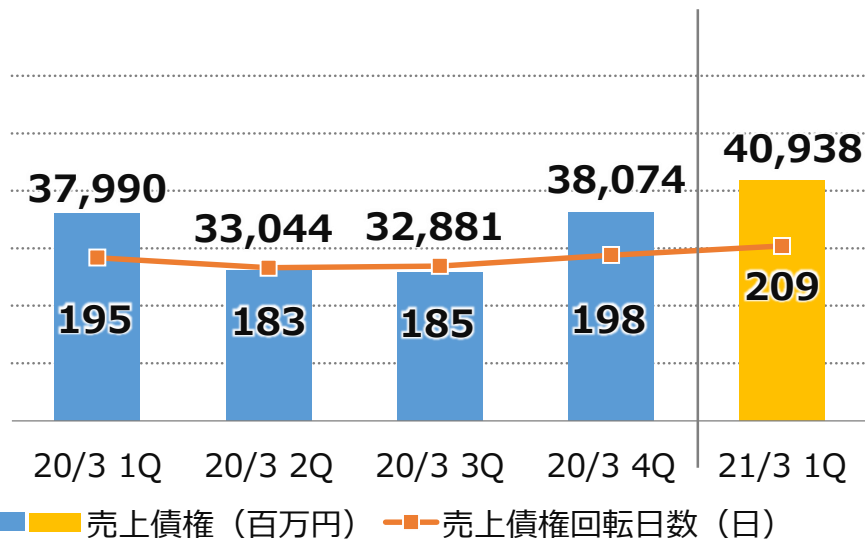
(単位：百万円)

■ 2020年3月期1Q

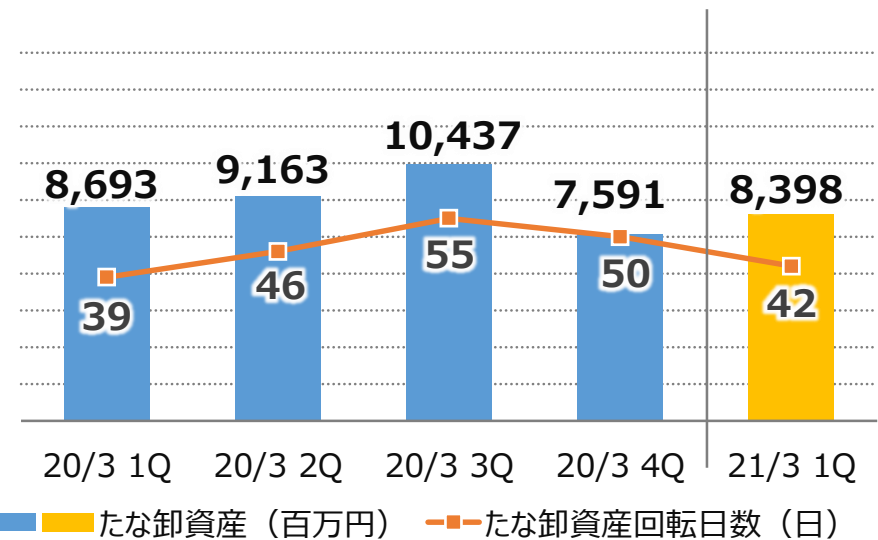
■ 2021年3月期1Q



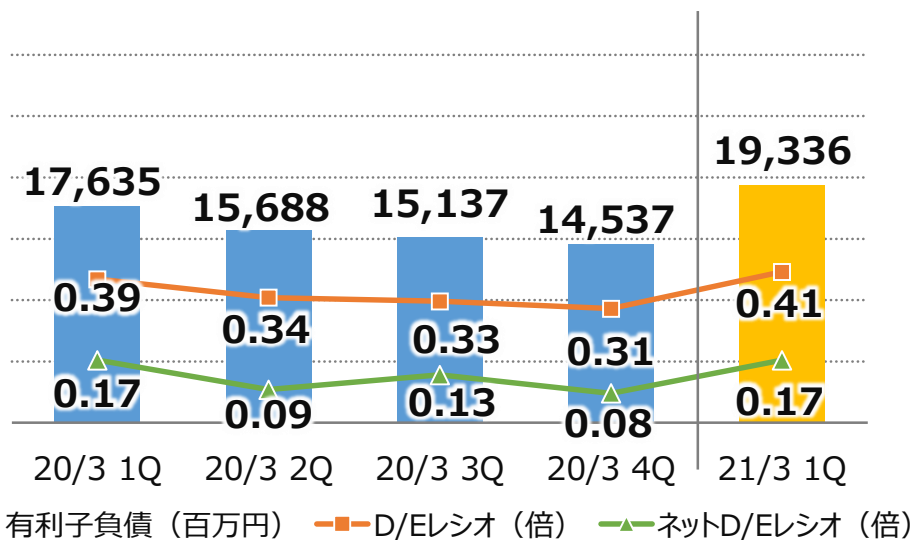
売上債権・売上債権回転日数



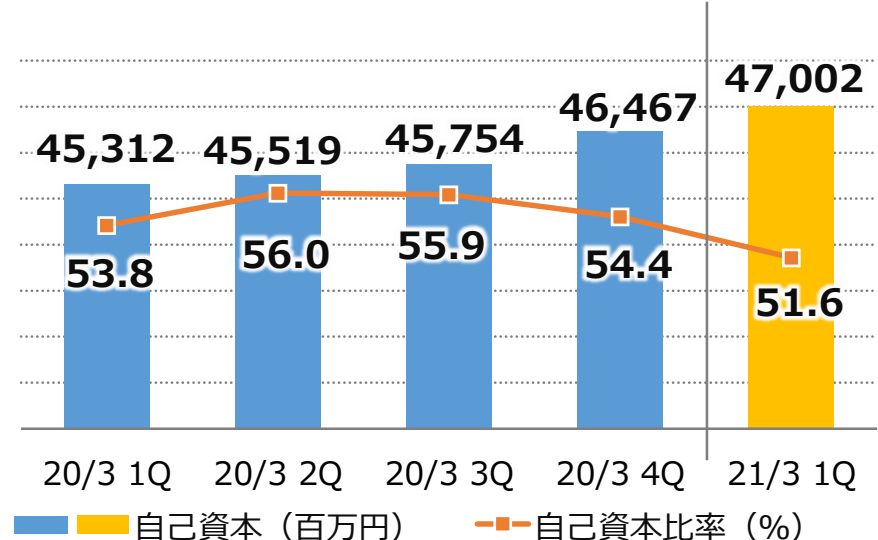
たな卸資産・たな卸資産回転日数



有利子負債残高・D/Eレシオ・Net D/Eレシオ



自己資本・自己資本比率



【注】売上債権回転日数、たな卸資産回転日数については、各四半期毎の期中平均値にて算出しております。

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。